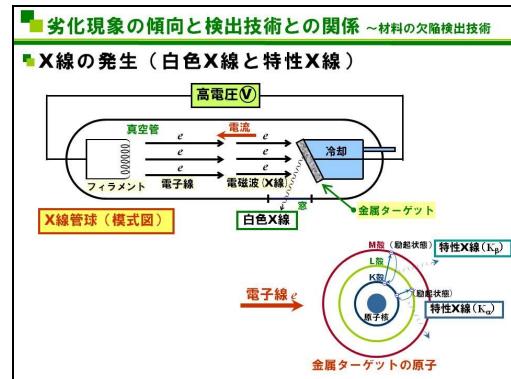


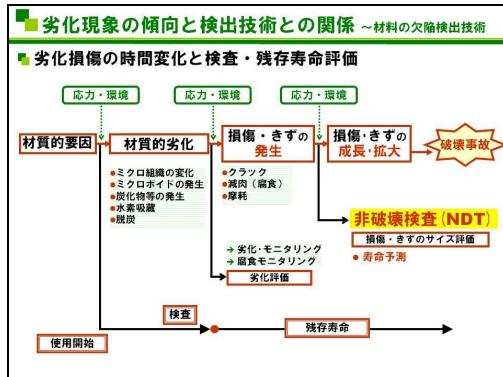
60

劣化現象の傾向と検出技術との関係 ~材料の欠陥検出技術		
物理現象	劣化検知手法	対象
光	・目視法 (レブリカ法、スンプ法) ・レーザホログラフィー	→組織変化・粒界腐食 →塑性ひずみ・疲労損傷
放射線	X線回折	→残留応力 →結晶のミスオリエンテーション →疲労・クリープ →熱処理によるせい化 →水素せい化・塑性変形
超音波	・減衰法 ・音速変化 ・散乱法 ・波形・周波数解析 ・磁気AE法	→結晶粒粗大化・水素せい化 →水素アタック・クリープ疲労 →結晶粒粗大化・偏析 →クリープ損傷・C相せい化 →クリープ損傷
電磁気	・漏水法 ・電気抵抗法 ・磁化曲線 (B-H曲線)	→クリープ損傷、第2相粒子の析出 →炭化物析出、クリープ疲労 →硬度変化
その他	・エキソ電子放射 ・電気化度計測 ・赤外線放射	→残留応力 →疲労損傷、塑性変形 →炭化物析出 (銀敏化) →疲労

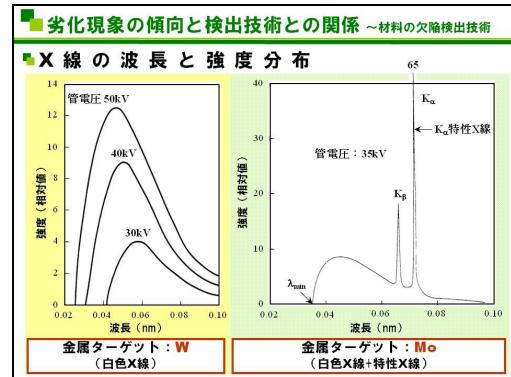
63



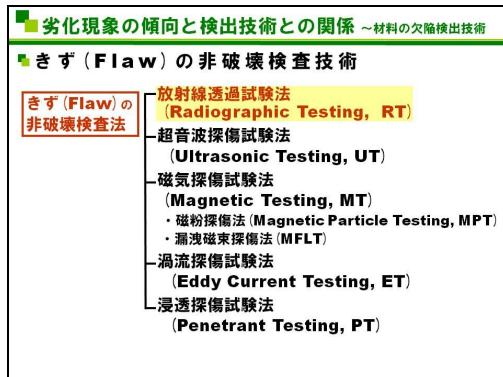
61



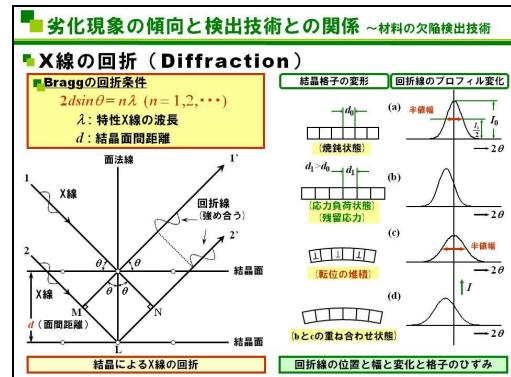
64



62



65



**劣化現象の傾向と検出技術との関係** ~材料の欠陥検出技術

**放射線(X線)の透過特性**

物質の原子番号  
物質の密度  
↓  
 $\mu$ は大

**特性X線の減弱曲線**

**劣化現象の傾向と検出技術との関係** ~材料の欠陥検出技術

**放射線透過試験方法(X線画像テレビシステム)**

X線管球  
X線  
パイプ  
レンズ系  
モニタ  
腐食減肉部  
プロセッサー  
カメラコントロール  
イメージ・インテンシファイア  
(X線感応素子)

**劣化現象の傾向と検出技術との関係** ~材料の欠陥検出技術

**白色X線の透過特性と散乱**

入射X線  $I_0$   
散乱線  $I_s$   
試験体  
X線フィルム  
点P  
直接透過線 I  
透過率  
(対数目盛)  
 $I_p/I_0 = I/I_0(1+n)$   
散乱比  $n = I_s/I$   
 $I/I_0$   
(1+n)倍  
試験体の厚さ  
散乱線がある場合の白色X線の減弱曲線

**劣化現象の傾向と検出技術との関係** ~材料の欠陥検出技術

**きず(Flaw)の非破壊検査技術**

**きず(Flaw)の非破壊検査法**

- 放射線透過試験法 (Radiographic Testing, RT)
- 超音波探傷試験法 (Ultrasonic Testing, UT)
- 磁気探傷試験法 (Magnetic Testing, MT)
  - ・磁粉探傷法 (Magnetic Particle Testing, MPT)
  - ・漏洩磁束探傷法 (MFAT)
- 湍流探傷試験法 (Eddy Current Testing, ET)
- 浸透探傷試験法 (Penetrant Testing, PT)

**劣化現象の傾向と検出技術との関係** ~材料の欠陥検出技術

**放射線透過試験**

$\mu(\text{銅}) \gg \mu^*(\text{きず})$

X線発生装置  
X線  
透過度計  
試験体  
 $\mu^*$   
 $\mu$   
きず  
 $\Delta x$   
厚さ x  
X線フィルム

**劣化現象の傾向と検出技術との関係** ~材料の欠陥検出技術

**超音波とは?**

**概要**

「人間の耳には聞こえないほど周波数の高い音」である。従って、一般に可聴音波の上限である**20kHz以上**の周波数の音波を**超音波**と呼んでいる。超音波探傷に使用されるものは**1~10MHz**が多い。

**特徴**

1. 波長が短い (指向性が鋭く、光の性質に似ている)
2. 弹性的な性質を持つ (音響物性変化の大きな境界面から反射する)
3. 固体中の伝播が良好 (熱エネルギーへの変換損失が少ない)

**利用方法**

医療診断、工業材料の探傷・物性評価、魚群探知機等の検査・探査分野や、超音波のエネルギーを利用した超音波加工・洗浄などに広く利用されている。

72

**劣化現象の傾向と検出技術との関係** ~材料の欠陥検出技術~

■超音波の波長( $\lambda$ )、音速( $C$ )と周波数( $f$ )の関係

$$\lambda = C/f$$

■音速  $C$ : 周波数  $f$ : 波長

■銅中の綫波音速  $C_L: 5900 \text{ (m/s)}$   
 $(C_S: 3230 \text{ (m/s)})$

■周波数 5MHz の場合  
 $\lambda = 1.2\text{mm}$

■検出可能な最小きず寸法  
 波長( $\lambda$ )の  $1/(3\sim 5)$

■超音波の波の種類

(a)綫波: 粒子の動き: 進行方向

(b)横波: 粒子の動き: 深さ

(c)表面波: 粒子の動き: 表面

■超音波測定に用いる波形と周波数・波長

波長:  $\lambda = 2\text{MHz}$   
 周波数:  $f = 5\text{MHz}$

75

**劣化現象の傾向と検出技術との関係** ~材料の欠陥検出技術~

■超音波探傷法の原理 2 - 斜角探傷法 -

探触子: 探傷角度: くさび深さ: ヒューム距離:  $W$ : 0: 屈折角: くさび内の連れ:  $W_F$

73

**劣化現象の傾向と検出技術との関係** ~材料の欠陥検出技術~

■超音波の送受信の仕組み

探触子に入っている振動子を振動させ、超音波を送受信する。振動子にはセラミックス・ポリマー・水晶などの圧電効果を持つ材料(圧電材料)が使用されている。

■圧電効果について

振動子(圧電材料)の両面に電極を付け、電圧をかけると振動子が伸縮する。  
 これを圧電効果(ヒエゾ効果)という。

逆に、超音波の音圧が振動子を伸縮させると電極間に電圧が発生し、これを電気信号として、超音波を受信することができる。

通常はパレス状の電圧をかける

76

**劣化現象の傾向と検出技術との関係** ~材料の欠陥検出技術~

■超音波簡易厚さ計の原理

■遮延式分割型探触子と板厚測定のための送信パルスとエコーの関係

受信: 送信: 音響分割面: 振動子: 表面: 裏面: 遮延材: T(送信パルス): B1(第1底面エコー): B2(第2底面エコー): S(表面エコー): T0: T1: T2: 時間

74

**劣化現象の傾向と検出技術との関係** ~材料の欠陥検出技術~

■超音波探傷法の原理 1 - 垂直探傷法 -

音響インピーダンス  
 $Z = C \times \rho$  (音速 × 物質密度)

接触媒質(水・マシン油): 探触子: 振動子: 表面: くさびで反射: 底面で反射: ハルサー/レシーバーに接続: 垂直探傷法

■オシロスコープの探傷图形

77

**劣化現象の傾向と検出技術との関係** ~材料の欠陥検出技術~

■コーティング上からの超音波板厚測定の原理

渦電流センサー: 超音波センサー: コーティング: 銅板: 腐食部: Tut: Tet: Tt: Tt = Tut - K · Tet: S-B1方式 (R-B1)

ここで  
 Tut: 測定された厚さ  
 K: 金属とコーティングの超音波音速比  
 Tet: 電磁厚さ計によるコーティング厚さ

78

**劣化現象の傾向と検出技術との関係** ~材料の欠陥検出技術

**超音波簡易厚さ計による測定**

塗膜上から測定した場合、簡易厚さ計が示す数値は  
材料自体の実際の厚さにはならない。

材料部分のみの厚さを知るために、**補正が必要**になる。

**本実験において**

実際の厚さ = 見かけの厚さ -  $\frac{\text{塗膜の厚さ} \times \text{鋼中の音速}}{\text{塗膜上の音速}}$

(約 35.2 mm) (約 0.6 mm) (約 6000 m/s)  
 (約 36.7 mm) (約 2400 m/s)

簡易厚さ計を用いて測定した**見かけの厚さ**から  
**実際の材料部分のみの厚さ**を求めることが出来る。

81

**劣化現象の傾向と検出技術との関係** ~材料の欠陥検出技術

**UT板厚連続面計測法**

Movement Direction

300mm (25mm x 12pieces)

25mm

32mm

Effective sensor width (25mm)

79

**劣化現象の傾向と検出技術との関係** ~材料の欠陥検出技術

**超音波厚さ計**

**ディジタル型の簡易厚さ計**

50

18cm

6.5cm

82

**劣化現象の傾向と検出技術との関係** ~材料の欠陥検出技術

**Method of data expression (1):**

Movement

Measuring unit

Segment (25mm x 5mm)

300mm

80

**劣化現象の傾向と検出技術との関係** ~材料の欠陥検出技術

**UT板厚計測における異常値表示について**

コーティング

探触子

振動子

超音波パルス

反射波

銅板

腐食 (局部腐食の曲率が厳しいとき)

T S B<sub>1</sub> B<sub>2</sub>

ゲート

83

**劣化現象の傾向と検出技術との関係** ~材料の欠陥検出技術

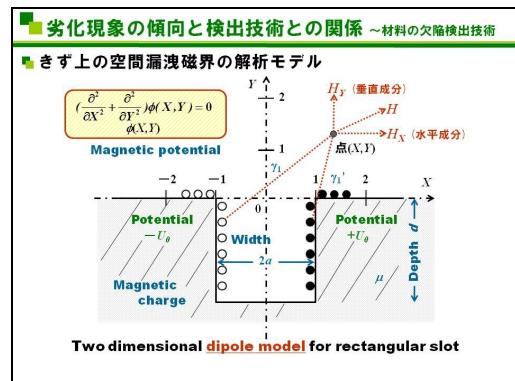
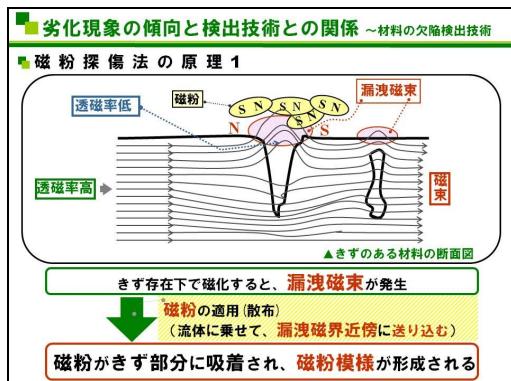
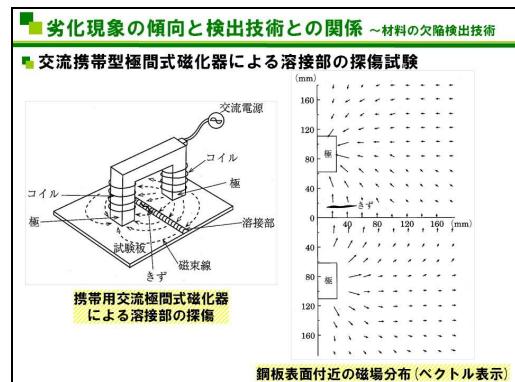
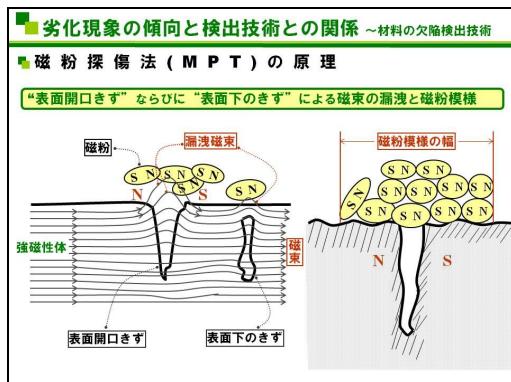
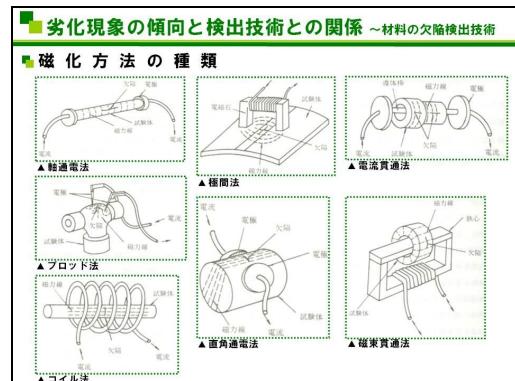
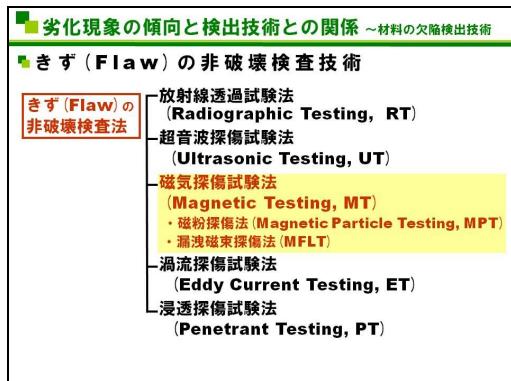
**Method of data expression (2):**

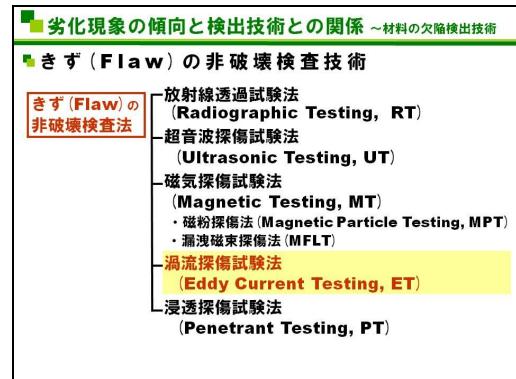
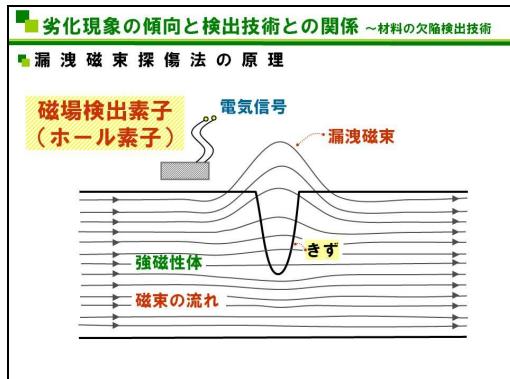
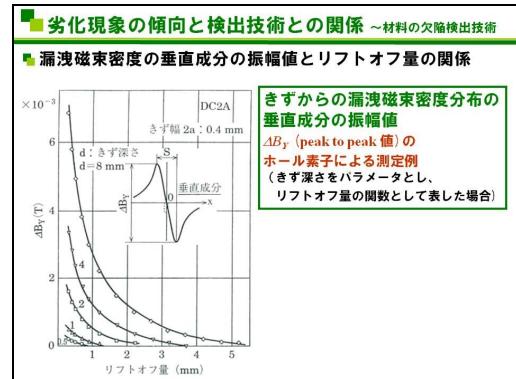
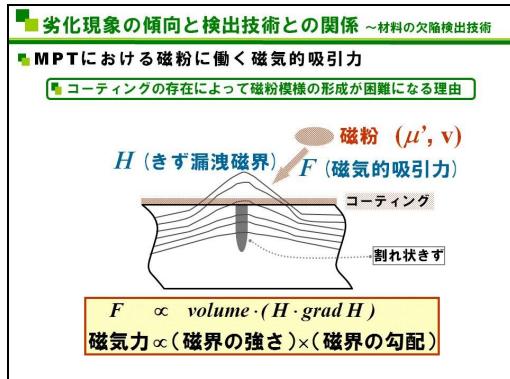
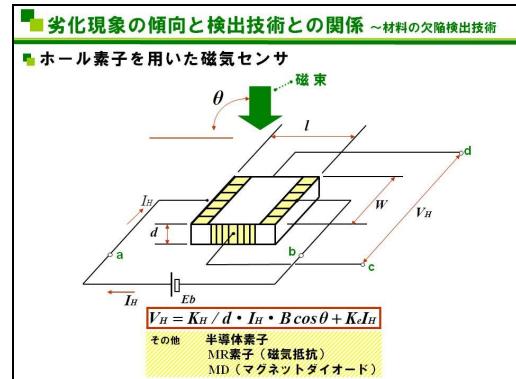
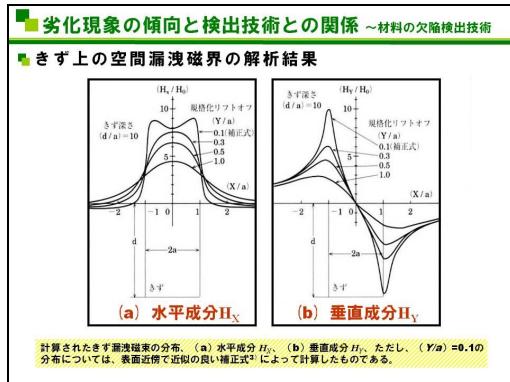
5mm

25mm

The lowest measured value represents the data for this segment.

A measured thickness





**劣化現象の傾向と検出技術との関係** ~材料の欠陥検出技術

**渦流探傷試験法の原理 I**

電磁誘導の法則：起電力  $\propto$  磁束の変化量

(a) 上置コイル  
導体に通す磁束  $\phi$  がコイルによって変化する。渦電流が生じ、その反作用で導体にさすきずがある場合、渦電流が減少する。

(b) 貫通コイル  
導体内部を貫通する磁束  $\phi$  がコイルによって変化する。渦電流が生じ、その反作用で導体にさすきずがある場合、渦電流が減少する。

**劣化現象の傾向と検出技術との関係** ~材料の欠陥検出技術

**表皮効果**

表皮効果とは・・・導体内部に浸透するにつれ、渦電流密度が指数関数に従って減衰する現象

表面からの距離  $x$  における渦電流密度  $J = J_0 \exp(-x/\delta)$

どの程度の表面きずを検出できるかに關係

表皮効果による表皮厚さ： $\delta(m) \quad \delta = 1 / \sqrt{\pi f \mu \sigma}$

$f(Hz)$ ：交流の周波数、 $\mu(H/m)$ ：導体の透磁率、 $\sigma(S/m)$ ：導体の導電率

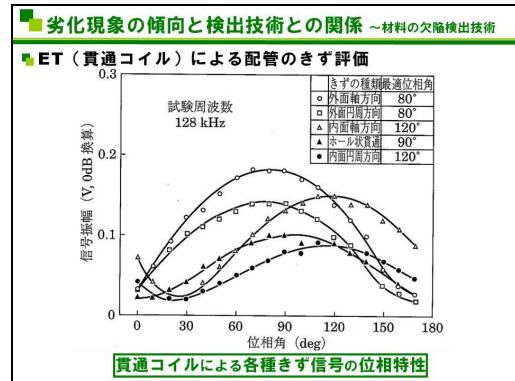
磁束密度が表面の約37%になる深さ  $\rightarrow$  表皮厚さ

**劣化現象の傾向と検出技術との関係** ~材料の欠陥検出技術

**渦流探傷試験法の原理 II**

自己比較方式・貫通コイル

自己比較方式・貫通コイル（充填率  $\eta = (b/a)^2$ ）



**劣化現象の傾向と検出技術との関係** ~材料の欠陥検出技術

**渦流探傷試験法の原理 III**

**内挿コイルによる渦流探傷試験法の原理**

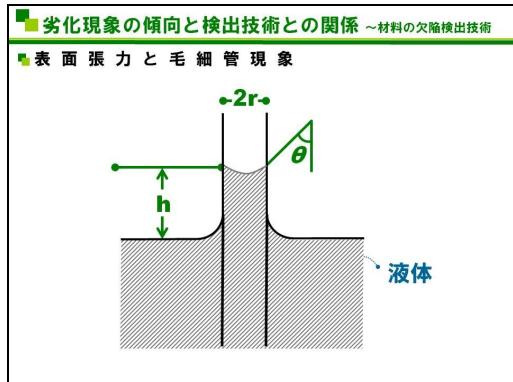
**劣化現象の傾向と検出技術との関係** ~材料の欠陥検出技術

**きず(Flaw)の非破壊検査技術**

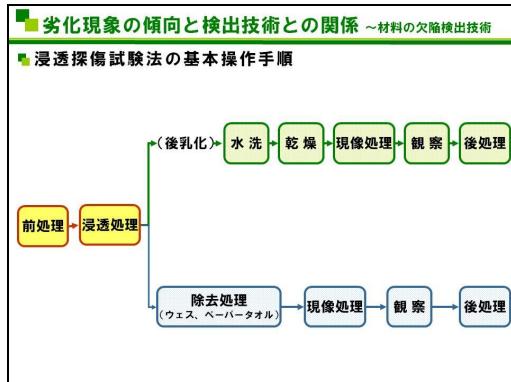
きず(Flaw)の非破壊検査法

- 放射線透過試験法 (Radiographic Testing, RT)
- 超音波探傷試験法 (Ultrasonic Testing, UT)
- 磁気探傷試験法 (Magnetic Testing, MT)
  - 磁粉探傷法 (Magnetic Particle Testing, MPT)
  - 漏洩磁束探傷法 (MFLT)
- 渦流探傷試験法 (Eddy Current Testing, ET)
- 浸透探傷試験法 (Penetrant Testing, PT)

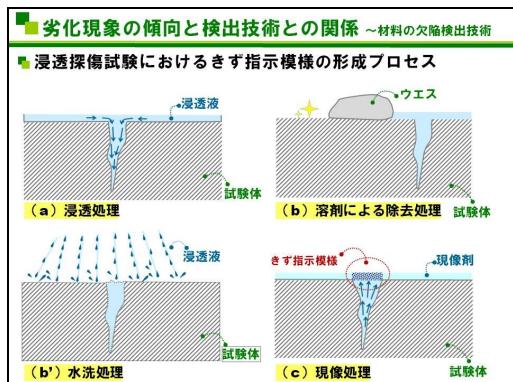
102



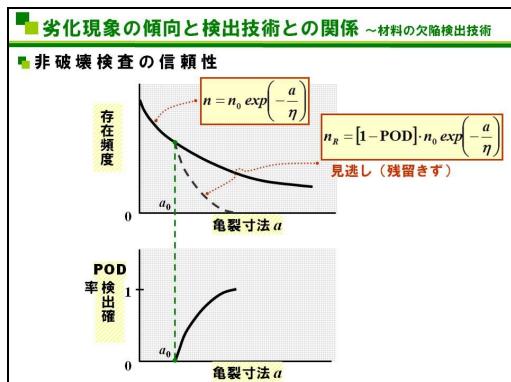
105



103



106



104

**劣化現象の傾向と検出技術との関係 ~材料の欠陥検出技術**

**浸透探傷試験法の種類**

<b>(1) 染色浸透探傷試験</b>		<b>(2) 蛍光浸透探傷試験</b>	
a) 溶剤除去性染色浸透探傷試験	b) 水洗性染色浸透探傷試験	a) 溶剤除去性蛍光浸透探傷試験	b) 水洗性蛍光浸透探傷試験
c) 後乳化性染色浸透探傷試験	c) 後乳化性蛍光浸透探傷試験		

107

- 劣化現象の傾向と検出技術との関係**
- コンクリート診断法**
- ◎ 可視画像処理
  - ◎ レーザー法
  - ◎ サーモグラフィ法
  - ◎ レーダー法
  - ◎ 打音法
  - ◎ 超音波法
- ひびわれ・  
はくり等の  
検出

109

108

■劣化現象の傾向と検出技術との関係

■腐食速度の検出・評価

- ◎電気抵抗法
- ◎溶出金属イオンの分析
- ◎水素発生量の分析
- ◎酸素消費量の分析
- ◎電気化学的測定法の適用

109

■材料の欠陥検出技術

■設備診断技術

「設備の現在の状態を同定し、  
その将来を予測する技術」

■検査技術・故障検出

- ①状態変数の測定
- ②信号処理
- ③特徴抽出
- ④特徴パターン照合
- ⑤評価予測

110